DERWENT-ACC-NO: 1979-70519B DERWENT-WEEK: 197939 COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Metal oxide film forming device, for e.g. piezoelectric thin films has chamber for exciting gas contg. oxygen, reaction chamber contg. glass substrate, metal gas supply and discharge port

PATENT-ASSIGNEE: TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO[TOKE]

PRIORITY-DATA: 1978JP-0009856 (February 2, 1978)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC

JP 54103791 A August 15, 1979

N/A

000 N/A

INT-CL (IPC): C03C023/00; C23C011/08

ABSTRACTED-PUB-NO: JP54103791A

BASIC-ABSTRACT: Device for forming a metal oxide film, e.g. piezo-electric thin films for elastic surface wave circuit elements use, where element consists of a zinc oxide thin film formed on a glass base and interdigital electrodes fixed to the film. The production yield is increased while avoiding the dispersion of film quality.

A chamber for exciting a gas containing oxygen, is followed by a reactor chamber containing glass substrates. A pipe is connected to the chamber for feeding a metal gas, e.g. Zn, into the chamber, which has a discharge port for discharging waste gas produced after the reaction in the chamber. The gas contg. oxygen may be excited by microwaves.

TITLE-TERMS:

METAL OXIDE FILM FORMING DEVICE PIEZOELECTRIC THIN FILM **CHAMBER EXCITATION GAS** CONTAIN OXYGEN REACT CHAMBER CONTAIN GLASS SUBSTRATE. METAL GAS SUPPLY DISCHARGE PORT

11/20/2002, EAST Version: 1.03.0002

ADDL-INDEXING-TERMS: ZINC OXIDE INTERDIGITAL ELECTRODE ZINC@

DERWENT-CLASS: L03 M13

CPI-CODES: L01-G05; L03-D04D; M13-E02;

⑩公開特許公報(A)

昭54-103791

DInt. Cl.2

識別記号

❷日本分類

庁内整理番号 ⑬公開 6737—4K

·開 昭和54年(1979)8月15日

C 23 C 11/08 // C 03 C 23/00

13(7) D 63 21 B 3

7106—4G

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

60金属酸化膜形成装置

20特

昭53—9856

20出

昭53(1978)2月2日

@発 明 者 清野弘

川崎市幸区小向東芝町 1 東京 芝浦電気株式会社総合研究所内 仍発 明 者 嵯峨明雄

川崎市幸区小向東芝町1 東京 芝浦電気株式会社総合研究所内

⑪出 願 人 東京芝浦電気株式会社

川崎市幸区堀川町72番地

仰代 理 人 弁理士 則近憲佑 外1名

2

明 細 1

- 1. 発明の名称 金属酸化膜形成装置
- 2. 特許請求の範囲
- (1) 少くとも酸素原子を含むガスが導入励起される ガス励起室と、該ガス励起室で励起された活性酸 素ガスが輸送系を介して導入される反応室と、該 反応室に載置される被膜形成基板上へ前配輸送系 と異なる系により金属ガスを導入せしめる手段と、 反応後のガスを前記反応室から排気する手段とを 備えてなることを特徴とする金属酸化膜形成装置。
- (2) 金属ガスが Zn ガスであることを特徴とする前 記特許請求の範囲第 1 項記載の金属酸化膜形成装 図。
- (3) 少くとも酸素原子を含むガスを、マイクロ波により励起することを特徴とする前配特許請求の範囲第1項配破の金属酸化膜形成装置。
- 3. 発明の詳細な説明

本発明は、金属酸化膜形成装置に係わり、特に弾性表面波楽子用圧電体薄膜等の形成に用いて最適な 金属酸化膜形成装置に関する。 最近、弾性表面波素子としてガラス基板上にZnO 薄膜を設け、該薄膜上にインターデジタル電極を設 けて構成したものが開発され、温度特性の改善が図 られている。

ところで、この2n0 薄膜は薫着法ないしはスパッタリング法を用いて形成されている。又、真空容器内に高周波コイルを設置し、放電で酸紫ガスをイオン化して高圧下で基板側を電極としてブレーテイングを行なう方法も開発されてきている。

然しながら、これらいずれの方法も酸化ガスを活性化する室と、実際の薄膜を形成する室とが同一室で行なわれている、被膜形成用基板側を加速電圧印加端としている等の為、薄膜形成のパラフキが生じやすく、弾性表面波素子等を製造した場合歩留りが低下するという問題が生じてきた。

本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、少くとも敬素を含むガスを励起する室と、反応室とを分離し、反応室へは別系統から金属ガスを導入し、 反応室で初めて両方のガスを反応させることにより 安定した金属酸化膜形成を行なうことの可能な装置

特開昭54—103791(2)

を提供するものである。

以下、本発明を一実施例により図面を用いながら 説明する。

ガス励起室(1)は、例えば100mの口径の石英管(2)を主体とし、この石英管(2)の一方端は、ガス導入口(3)を有し、他方端は、石英管(2)内で励起されたガスの出口(4)を有している。そして、石英管(2)のほぼ中央外部に位置して、マイクロ被励起手段(5)の内、ショートブランジャーチューニング機構(6)付導被管(7)が、前記石英管(2)を貫通する如く設けられている。この導放管(7)へは図示しないマイクロ液電源(例えば2.45 GHz、680W)よりマイクロ液エネルギーが伝達される。又、石英管(2)は、冷却手段(8)により一定管壁温度に保持されている。

このようなガス励起室(1)に、ガス導入口(3)を介して、少くとも酸素を含むガス例えば不活性ガスで希釈された酸素ガス(9)が、例えば数 Torrの圧力で 導入され、マイクロ波により励起されて、酸素プラズマが発生する。勿論、マイクロ波に代つて13.56 MHs

これを、前配反応室側内の台上に載置し、0.1~1 Torr程度の真空状態で、2nO膜(202)を形成 した。膜厚としては、1.6 pm を選択し、数分~数 十分で形成出来た。膜厚は数 p~10 p 程度が望ま しい。この時、基板(200)の載置される台は、 加熱手段により、例えば80℃に加熱した状態で保持した。反応後のガスは、排気口師を介して排出る。 が成した2nO膜(202)は結晶性もすぐれ、十分 足のいくものが得られた。しかる後、この2nO 膜上へ対向電極膜例えばAu、As 膜を蒸着形成して、 学性表面波索子を作成したところ、例えば温度特性 も-30ppm/C~+30ppm/C程度の物が得られた。

金属ガスとして、Li及びTaを同時にガス化して用いると、2nの薄膜の代りに、LiTaO。薄膜の形成も可能であつた。このようにして、弾性表面波索子を作成したところ、前配実施例同様良好な特性のものが得られた。

勿論、本発明装置は基板が金属であれ、絶 物で あれ、制限なく以上の通り、本発明装置によれば、 の高周波励起や、レーザー光励起等様々な励起方法 が可能である。

次に、ガス励起室(1)で励起され活性化した酸素ガスは、石英製輸送管型を介して、反応室四内へ導入される。反応室四内には、基本的には真空容器であり、この反応室四内には、被膜形成用基板(2)が較置される台口が設けられている。この台四へは、基板加熱用の電源四及び、温度検出用の熱電対四が接続されている。

一方、この反応室四へは、前配輸送管(II)とは別系統の輸送管四を介して、金属ガス例えば Zn ガス 図が導入される。 Zn ガスは、反応室に置かれた 基板 四に対し、上方から吹きつけるように構成した。 Zn ガスは、金属亜鉛を通常のヒーター加熱により真空中にて製造した。

次に、本装置により弾性表面波用素子を製造する場合について説明する。基板として、厚さ例えば U.5~U.8 mmのガラス基板 (200)上に、例えば厚さ1~数 μ の金 (Au)層を設け、くし形電極パターン)(201)に形成したものを用意する。そして、



ガス励起室と反応室とが分離されており、励起状態に左右されず値類性の高い金属酸化物薄膜の形成が容易となると同時に、ガス制御が容易となり装置制御性が向上した。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明装置の一実施例を説明するための 概略構成図、第2図は40~10は図1図に示す装置を 用いて案子を形成する方法を説明するための断面図 である。図において、

1 ····· ガス励起室 10 ····· 輸送管 20 ····· 反応室。

代理人弁理士 則 近 懲 佑 (ほか1名)

